

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2020-121

债券代码: 114418、114423 债券简称: 19 康佳 01、19 康佳 02

114488、114489 19 康佳 03、19 康佳 04

114523、114524 19 康佳 05、19 康佳 06

康佳集团股份有限公司

关于与南昌经济技术开发区管理委员会 签订合作框架协议的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本合作框架协议项下涉及到的各个项目具体实施时,将分别由具体实施项目的企业与南昌经济技术开发区管理委员会另行签订具体的项目合作协议。对于涉及到本公司的具体项目需要在履行本公司相应的审批程序后才能实施。

2、对于本合作框架协议中约定的江西康佳半导体高科技产业园及配套股权投资基金,本公司将根据项目的进展情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求,履行相应的审批程序,并按照相关要求信息进行信息披露。

3、本次签署的合作框架协议将在协议生效后逐步实施,预计对本公司2020年度经营成果无重大影响。

一、合作框架协议的概况

为加快在半导体等战略新兴产业布局,康佳集团股份有限公司(以下简称“本公司”)与南昌经济技术开发区管理委员会(以下简称“南昌经开区管委会”)于近日签署了《合作框架协议》,合作框架协议的主要内容为本公司拟与南昌经开区管委会在南昌经开区管委会辖区内共同建设江西康佳半导体高科技产业园(以下简称“半导体产业园”)及共同设立配套股权投资基金。

合作框架协议的生效条件为双方签字并盖章,且经本公司履行相应的审批流程。

对于本合作框架协议中约定的相关项目,本公司将待具体方案明确后根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求,履行相应的审批流程,并按照相关要求信息进行信息披露。

二、合作框架协议的主要内容

(一)签约主体:南昌经济技术开发区管理委员会和康佳集团股份有限公司。

(二)主要内容:

1、本公司拟与南昌经开区管委会在南昌经开区管委会辖区内共同建设半导体产业园。其中本公司负责在半导体产业园引进一批符合半导体产业园定位的半导体及相关产业链项目，并将该半导体产业园作为半导体企业孵化平台，积极引进半导体专业研发团队及半导体初创企业入驻。

2、半导体产业园项目建设期为10年，分两期建设，力争建设期内总投入达到300亿元，其中一期项目总投资力争达到75亿元，不低于50亿元，上述投资将主要由半导体产业园的入园企业投资。

3、本公司拟与南昌经开区管委会管理的指定企业共同组建服务于半导体产业园项目的股权投资基金，该基金计划规模上限为20亿元人民币，预计分两期到位，每期金额上限为10亿元。实际投资额度由各出资方协商确定。该基金拟以市场化股权投资方式投入半导体产业园的入园企业。

4、合作框架协议为双方合作的框架性协议，合作框架协议项下涉及到的各个项目具体实施时，分别由具体实施项目的企业（以下简称“项目企业”）与南昌经开区管委会另行签订具体的项目合作协议，具体项目实施细节在各具体的项目合作协议中进行具体约定。若各项目企业与南昌经开区管委会签署的具体的项目合作协议与合作框架协议有冲突的，以具体的项目合作协议为准。

（三）生效条件：双方签字并盖章，且经本公司履行相应的审批流程。

本公司将根据南昌经济技术开发区当地的相关政策，积极申请优惠政策。

三、对本公司的影响

本合作框架协议的签署，符合本公司“半导体+新消费电子+科技园区”核心主线的战略定位，有助于公司完善半导体产业布局，夯实在半导体领域的影响力，助力本公司从“康佳电子”向“康佳科技”转变。因项目实施需要一定周期，预计本合作框架协议的履行对本公司2020年度财务状况、经营成果无重大影响。

四、风险提示

（一）本合作框架协议项下涉及到的各个项目具体实施时，将分别由具体实施项目的企业与南昌经开区管委会另行签订具体的项目合作协议。对于涉及到本公司的具体项目需要在履行本公司相应的审批程序后才能实施。

（二）对于本合作框架协议中约定的半导体产业园及配套股权投资基金，本公司将根据项目的进展情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的审批程序，并按照相关要求信息进行信息披露。

（三）相关项目的具体实施方案可能与合作框架协议的内容存在差异。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件。

《合作框架协议》。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二〇年十一月十一日